

檔 號：

保存年限：

衛生福利部中央健康保險署 開會通知單

10846

台北市長沙街2段73號3樓

受文者：台北市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國103年1月21日

發文字號：健保審字第1030034810號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議議程乙份

開會事由：全民健康保險特殊材料給付相關事項討論會

開會時間：103年1月28日（星期二）上午10時

開會地點：本署18樓禮堂（台北市大安區信義路3段140號）

主持人：沈組長茂庭

聯絡人及電話：羅家儀（02）27065866轉3020

出席者：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台北市美國商會、歐洲在台商務協會、台北市日僑工商會醫藥品部會醫療器材委員會、台北市儀器商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、本署醫務管理組

副本：本署醫審及藥材組

衛生福利部中央
健康保險署投對章(3)

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險特殊材料給付相關事項討論會議程

時間：103 年 1 月 28 日上午 10~12 時

地點：衛生福利部中央健康保險署 18 樓禮堂

主席：沈組長茂庭

一、主席致詞

二、報告事項：

(一)特材自費規範實施後，應內含於相關診療項目支付點數中之醫材處理
流程。

(二)特材差額上限訂定原則修訂重點。

三、綜合討論

四、主席結語

五、散會